TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đà Nẵng: Khởi động phòng thí nghiệm vi mạch bán dẫn công suất 10 triệu sản phẩm/năm

16:28 28/07/2025

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự kiến công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.



Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khởi công.

Ngày 28/7, tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Fab-Lab).

Cùng dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo TP. Đà Nẵng,Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.

Dự án Fab-Lab là mô hình tiên phong tại Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển công nghệ lõi, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 30/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được đầu tư với tổng vốn 1.800 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 2.288m2, tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m2, dự kiến đưa vào vận hành vào quý IV/2026.



Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của đóng gói – kiểm thử như một mắt xích chiến lược, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Dự án là mô hình phối hợp linh hoạt giữa Nhà nước và doanh nghiệp, với phòng Lab là trung tâm thử nghiệm đổi mới sáng tạo, đặt nền móng đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng TP.Đà Nẵng trong xây dựng cơ chế hỗ trợ hạ tầng nghiên cứu – thử nghiệm, kết nối các chương trình quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực đóng gói, thiết kế, kiểm thử vi mạch.

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu trong nhiệm kỳ 2025–2030. VSAP Lab được kỳ vọng trở thành mô hình “lab-fab” kiểu mẫu –

tích hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và đào tạo – phục vụ đóng gói vi mạch tiên tiến cho chip AI, cảm biến, y sinh và thiết bị giao tiếp tốc độ cao.



Dự án được đầu tư với tổng vốn 1.800 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 2.288m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m², dự kiến đưa vào vận hành vào quý IV/2026.

“Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, cơ chế hành chính và nguồn nhân lực để dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. VSAP Lab sẽ là hạt nhân hình thành cụm đổi mới sáng tạo ngành bán dẫn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước và kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút chất xám, là cái nôi của công nghệ đóng gói tiên tiến Make in Vietnam”, ông Triết nhấn mạnh.

Dự án được chia thành hai khu vực chính: Khu vực phòng lab (tập trung nghiên cứu và phát triển các công nghệ đóng gói mới như Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP), 2. 2.5D/3D IC, Silicon Interposer và Silicon-Bridge) và khu vực phòng Fab (thực hiện sản xuất thử nghiệm trên wafer thật, với các thiết bị tiên tiến như: Lithography (quang khắc), wafer bonding và hệ thống đo kiểm đạt chuẩn quốc tế).

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự kiến công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Lê Dũng